



工業技術研究院・三井住友銀行共催

「最先端技術セミナー&マッチング」

台湾政府系研究機関の工業技術研究院（以下 ITRI）は 25 日、三井住友銀行と共催で、「最先端技術セミナー&マッチング」のオンラインセミナーを開催しました。

半導体パッケージング技術、化合物半導体や材料化学などの旬な 5 つのテーマに焦点を当て、ITRI が保有する最先端技術について、日本企業との共同研究や、日本企業への技術移転に繋げることが目的です。

ITRI が日本の金融機関と協力し、半導体パッケージング技術のパートナー公募を行うのは初の試みで、オンラインセミナーには日系企業の関係者ら 150 人以上が参加しました。

ITRI 副院長の張培仁氏は、「ここ最近、台湾を代表する T S M C が日本に半導体工場を設立するなど、台湾の半導体産業界には良いニュースが相次いでいる。ITRI はこれまでに日本企業との協力関係を成功させた事例も多く、実際に日台間の友情と、深い信頼関係を証明している」と述べました。ITRI 日本事務所駐日代表の楊馬田氏は、「今回のセミナーを通じて、技術開発の分野で日本企業と台湾企業の繋がりがより一層深まることを願う」とコメントしました。

三井住友銀行法人戦略部長の池口亮二氏は、「日本企業と ITRI 様との間で、新たなイノベーションが生まれ、より良い社会・未来が作られていくことに期待する」と述べました。また、同行台北支店長の加藤芳郎氏は、「台湾では足元の半導体産業に加え、新産業の育成が大きなテーマとなる中、ITRI と日本企業間の交流がより活発になることを願うとともに、新たなビジネス創出のご支援を継続していきたい」とコメントしました。

三井住友銀行では 2022 年 2 月 14 日、ITRI と日本企業との間の新たなビジネス創出支援を目的とした個別商談会を開催する予定です。ITRI は研究機関でありながらスタートアップの育成にも注力をしており、これまでに上場企業を含む約 300 社の企業を技術面で支援・輩出してきました。その中には世界最大の半導体メーカー TSMC や UMC など台湾の大手半導体ファウンドリーなども含まれます。ITRI と三井住友



銀行は、2014 年にビジネスマッチングに関する業務提携を締結し、これまでも複数の協働事例を手掛けています。

【当記事に関するお問い合わせ】

工業技術研究院（ITRI）広報部 劉家妤 Ms. Kayo Liu

Tel：+886(0)936-606-694

E-mail：KayoLiu@itri.org.tw